

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 226,696,955 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.51 元（含税），共计派发现金红利人民币 11,561,544.71 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	胡译
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
电子信箱	info@wlcspp.com	info@wlcspp.com

2 报告期公司主要业务简介

（1）公司主营业务：公司专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，为全球晶圆级芯片尺寸封

装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、微机电系统芯片（MEMS）、环境光感应芯片、医疗电子器件、射频芯片等，该等产品广泛应用在消费电子（手机、电脑、照相机、游戏机）、安防监控、身份识别、汽车电子、虚拟现实、智能卡、医学电子等诸多领域。

（2）公司经营模式：公司为专业的集成电路测试服务提供商，业务模式为客户提供晶圆或芯片委托封装，公司根据客户订单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，由生产部门组织芯片封装、测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收取封装测试加工费。

公司生产所需原辅材料通过采购部直接向国内外供应商采购，具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合格后仓库入库并由生产领用。

（3）行业情况说明：公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。集成电路产业链是半导体产业的典型代表，因为其技术的复杂性，产业机构向高度专业化转化，可细分为 IC 设计业、芯片制造业及 IC 封装测试业三个子产业群。由于具备成本和地缘优势，我国集成电路封装测试产业获得了快速发展，随着国外半导体公司的产业转移与我国半导体企业的兼并浪潮，目前我国已成为全球集成电路的主要封装基地之一，封装测试业也成为我国半导体产业的发展主体，在市场、技术、产业链等全面向国际先进水平靠拢，2016 年我国集成电路封装测试销售收入规模为 1,564.3 亿元，占我国集成电路产业总销售收入比重为 36.08%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,934,850,691.05	1,998,451,514.31	-3.18	2,048,488,734.82
营业收入	512,390,368.91	575,718,355.28	-11.00	615,810,322.31
归属于上市公司股东的净利润	52,753,271.75	113,275,303.59	-53.43	196,310,877.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性	33,712,978.49	77,364,485.88	-56.42	167,551,525.92

损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	1,674,305,721.67	1,647,805,449.22	1.61	1,572,291,922.29
经营活动产生的现金流量净额	110,533,010.91	206,656,321.74	-46.51	239,583,810.31
基本每股收益（元/股）	0.23	0.50	-54.00	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.50	-54.00	0.88
加权平均净资产收益率（%）	3.18	6.95	减少3.77个百分点	13.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	122,568,246.49	115,837,148.21	112,031,938.84	161,953,035.37
归属于上市公司股东的净利润	16,089,538.45	9,833,435.20	4,339,499.96	22,490,798.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,529,213.15	4,173,271.27	753,523.62	18,256,970.45
经营活动产生的现金流量净额	20,058,233.07	33,565,268.48	21,477,601.57	35,431,907.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					25,799		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					24,372		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD	0	57,160,964	25.21	57,160,964	质押	48,600,000	境外法 人
中新苏州工业园区 创业投资有限公司	0	55,048,276	24.28	55,048,276	质押	15,700,000	国有法 人

OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) COMPANY LIMITED	-22,669,694	7,591,993	3.35	0	无	境外法人
英菲尼迪—中新创业投资企业	0	6,724,819	2.97	6,724,819	无	其他
中国证券金融股份有限公司	0	4,929,784	2.17	0	无	未知
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	0	3,826,731	1.69	3,826,731	无	境内非国有法人
GILLAD GAL-OR	0	3,530,530	1.56	0	无	境外自然人
苏州豪正企业管理咨询有限公司	0	3,236,688	1.43	3,236,688	无	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	2,829,300	1.25	0	无	未知
晶磊有限公司	0	1,060,368	0.47	1,060,368	无	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

2016 年全球半导体仍处于周期性调整，根据美国半导体协会（SIA）公布数据，全球半导体产业 2016 年实现营收 3389 亿美元，较 2015 年微幅增长 1.1%。我国集成电路产业在产业政策、并购整合、外资加大投资等多因素推动下虽然保持较快增长态势，但增速持续下滑，行业面临较大的经营压力。

在此背景下，公司持续专注于传感器领域的封装业务，技术上以市场和客户需求为导向，坚

持技术持续创新和知识产权体系的全球布局，推动技术、工艺的持续升级与优化，以适应市场发展和新领域、新产品的的需求；不断提升 8 英寸、12 英寸 3D TSV 封装技术的工艺能力与生产规模水平，巩固并提升公司在该领域的技术领先优势与市场规模优势；持续创新生物身份识别芯片封装技术，利用自身的技术和 IP 优势、通过对所收购资产的模组技术与整合能力进行刻制创新与有效整合，具备 trench、TSV、LGA 等多样化的封装技术及全方案服务能力；积极发展高阶产品扇外型封装技术、系统级封装技术、汽车电子产品封装技术等多种新应用领域的技术开发与认证，以顺应产业的发展步伐与新的市场机遇；持续着力于测试、模组技术的开发与提升，以实现业务与技术的有效延伸与产业链拓展。

在市场与业务上受全球智能手机增速放缓，行业整体需求疲软，去库存压力较大的影响，公司的业务与市场竞争更趋激烈，整体销售额与盈利水平较 2015 年下滑。面对日益激烈的市场竞争，公司一方面不断强化优势业务，持续提高市场占有率；针对影响传感芯片、生物身份识别芯片等优势业务领域，减持技术的持续创新与优化，延伸产业链，向测试业务环节有效扩展，不断缩短生产周期、降低客户成本，以持续提升自身竞争优势与产业增值服务能力，增强客户合作粘度；另一方面持续努力着手于新产品与新应用市场的拓展，并在安防监控、生物身份识别模组等领域取得了快速发展，持续拓展 MEMS、VR/AR、3D 摄像等新兴市场，以提高新兴市场的渗透比率与速度，提升市场份额，扩大业务规模；重点着力于汽车电子、智能制造等工业类领域的 IP 积累、工艺认证与市场拓展，以把握未来汽车电子、智能制造等传感器市场的发展机遇。同时，通过持续加强客户拓展，提升公司核心客户群体，实现并保持与全球主要设计公司的战略合作，为公司的后续发展奠定良好的产业与市场地位。

管理运营上不断加强内部管理与资源整合，推动事业部管理模式的不断深化与精细化，持续推进内部管理模式改革与管理水平的提升，以有效提升生产效率、降低管理成本。进一步积极整合收购的智瑞达科技相关资产、业务技术与人才资源，并与公司现有的技术和人才队伍进行融合，有效提升公司技术的全面性与延伸性，并使公司具备封装-测试-模组的全方案服务能力，为公司的未来发展奠定新的业务基础与业务模式。

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 512,390,368.91 元，同比下降 11%，实现营业利润 42,239,715.45 元，同比下降 60.58%，实现净利润 52,753,271.75 元，同比下降 53.43%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

受影响的报表项目	影响金额（元）
税金及附加	2,113,709.47
管理费用	-2,113,709.47

公司编制并披露了《晶方科技关于公司会计政策变更的公告》，详见2017年4月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	晶方半导体科技（北美）有限公司	晶方北美	100.00	—

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2017年3月31日